

「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業／先端半導体製造技術の開発」

実施予定先一覧

No.	開発テーマ	実施予定先
1	(d) 国際連携による次世代半導体製造技術開発 (d4)2nm世代半導体のチップレット・パッケージング設計・製造技術開発（委託）	R a p i d u s 株式会社

以上